NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心

文件名稱:設備作業標準(SE-028 電子槍蒸鍍系統)文件編號:Q3-NL04制訂部門:異質整合製程組制訂日期:2019-02-15

文件制修訂記錄

版本	編製者	生效日期	核定文號	改版/變更說明	修訂頁次
1.0	李彦希	2019-02-22	IS108008	制定新版	
1.1	李彦希	2021-04-15	IS110003	文件名稱原「設備作業標準(SE-C08 電 子槍蒸鍍系統)」更改為「設備作業標準 (SE-028 電子槍蒸鍍系統)」	封面

NARLab	s 國家實驗研究院	DOCUMENT NO. :	TITLE :			
台灣半	Q3-NL04	設備作業標準 (SE-028 電子槍蒸鍍系統)				
ISSUE DATE	2021-04-15	REVISION	1.1	PAGE	第 1/2 頁	

一、目 的:

定義電子槍蒸鍍系統操作規範,以確保操作品質。

二、範 圍:

適用於電子槍蒸鍍系統。

三、權 責:
1. 組織權責:工程師負責制定及修改規範。

2. 執行人員資格:經過電子槍蒸鍍系統考核通過之人員。

- 四、名詞定義: 無。
- 五、相關文件:

無。

- 六、標準作業程序:
 - 1. MES 控制系統開啟設備
 - 2. 操作前檢查項目:

2.1. 檢查冷卻水水流量 2kg/cm²

2.2. 檢查氮氣二次盤面流量 7kg/cm²

3. 鍍膜製程:

3.1. 點選進入『半自動』畫面後按下【破真空】按鈕。

3.2. 等待破真空結束,【ATM】亮起,放入試片、金屬錠、鎢舟和襯鍋等製程材料

- 3.3. 設定膜厚計監控器
 - 3.3.1. 按下【Next Menu】選擇操控頁面
 - 3.3.2. 按下【Process Menu...】進入參數設定
 - 3.3.3. 選轉旋鈕至所需要的參數後按下【Edit...】,進入膜層順序設定
 - 3.3.4. 選轉旋鈕至所需要的參數後按下【Edit...】,進入膜層參數設定
 - 3.3.5. 更改【Init Rate】 鍍膜速率 和更改【Final Thickness】, 鍍膜厚度。
 - 3.3.6. 按下【To main】回到起始畫面

NARLab	DOCUMENT NO. :	TITLE :			
台灣当	Q3-NL04	設備作業標準			
			(SE-028 龟	丁怊 烝銀系 統)	
ISSUE DATE	2021-04-15	REVISION	1.1	PAGE	第 2/2 頁

3.4. 進入『鍍膜參數』畫面按下【Film 更新】後檢查和設定參數

3.5. 進入『自動』畫面

3.5.1. 按下【更新】, 並選擇參數

3.5.2. 按下【自動鍍膜】

3.6. 等真空達基本壓力(Base pressure),約為 8E-7 Torr,聽到提示音後,按下【鍍膜】

3.7. 進入『資料收集』畫面內監控鍍膜情形

3.8. 鍍膜厚度達到後,結束鍍膜製程

3.9. 破真空,拿取試片和清潔腔體

4. 回『半自動』畫面,選取【抽真空】

5. MES 控制系統 關閉設備。

七、應用表單及附件:

1. Q4-NL02 設備管理卡

2. Q4-NL03 設備考核表

3. Q4-NL04 設備點檢表

4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單